

普冉半导体(上海)股份有限公司

2023年度报告摘要



(1) MCU产品

MCU是微控制单元,又称单片机,是CPU(中央处理器)的频率与规格通常缩减,并将在工业、消费电子、AVD控制、DMA等周边电路,甚至包括TP-LCD、LED驱动电路等整合在一起,芯片上形成的芯...

公司基于先进工艺和超低功耗与集成度自有的设计存储优势,布局ARM Cortex-M内核系列32位通用MCU产品...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...

报告期内,公司从功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展MCU产品系列...

公司基于ARM内核的M4 MCU产品目前已有一个系列10余款量产出货,产品主要用于智能家居、小家电等场景...



4.3公司实际控制人之间的股权及控制关系的方框图



4.4报告期内公司优先股股东及其前10名股东情况

1.公司实际控制人根据重要原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项...

1.公司实际控制人根据重要原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项...

1.公司实际控制人根据重要原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项...

普冉半导体(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

1.募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 (二)募集资金专户存储情况

2.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

Table with 4 columns: 项目, 金额, 单位, 备注. Lists various projects and their funding amounts.

3.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

4.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

5.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

6.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

7.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

8.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

9.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

10.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

11.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

12.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

13.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

14.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

15.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

16.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

17.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

18.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

19.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

20.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

21.募集资金使用管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

2.风险提示 公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。

3.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。 5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上半年未盈利且尚未实现盈利。 7.董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

公司以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本拟减公司回购专用证券账户中股份为基数,以该基数为基数,按照每10股转增1股的比例,向全体股东派发现金股利,并派发现金股利,派发现金股利总额为人民币1,600,000.00元,占2023年度末归属于母公司所有者的净利润的10.16%。

如在公司董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本拟减公司回购专用证券账户中股份发生变动,公司将按照前述比例不变,相应调整拟派现金股利,并另行公告具体调整情况。

根据《上市公司回购股份规则》等相关规定,上市公司现金分红时,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2.第二节 公司简介 1.公司简介 公司代码:688766 公司简称:普冉股份

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists company information like name, address, and website.

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务情况 公司的主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。

公司目前主要业务是非易失性存储芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括:NOR Flash/EEPROM两大类非易失性存储芯片、微控制器芯片等,其中非易失性存储芯片用于通用型芯片,可广泛应用于手机、计算机、网络设备、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。